

Die Teilnahme am Verpackungstag kostet 450,- Euro zzgl. MwSt. pro Teilnehmer

Der Verpackungstag findet am 14. November 2018 von 9 - 18 Uhr in Heidelberg statt

Titel, Name, Vorname

E-Mail

Funktion im Unternehmen

Firma

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Telefonnummer

Datum, Unterschrift

Ja, ich/wir nehme(n) mit \_\_\_\_\_ Person(en) teil.

SEW lädt zu einem Rundgang beim Kunden ein – den SiSi Werken in Heidelberg

Programmänderungen vorbehalten

(Bei mehreren Personen bitte die Namen zusätzlich angeben!)

Anmeldung per Fax: +49 (0) 7141 2231-31  
per E-Mail: [verpackungstag@agt-verlag.de](mailto:verpackungstag@agt-verlag.de)  
oder online auf: [www.verpackungstag.de/ticket](http://www.verpackungstag.de/ticket)

#### MICRO FAIR

#### Wie nutzen Verpackungsmaschinen die Vorteile der IT und der Automatisierung?

Gezeigt werden auf der MicroFair Lösungen zu: Bewegungssteuerung, Mess- und Regeltechnik, Robotik (Cobots), integrierte Safety, elektrische und pneumatische Antriebstechnik, Visualisierung, Sensorik, Maschinenbedienung, maximale Vernetzung, Virtual Reality und Augmented Reality. Dazu werden u. a. Etikettier-Lösungen präsentiert. Auf der kleinen Messe zum 3. Verpackungstag geht es auch um die Frage, ob es die schlüsselfertige Verpackungslösung gibt, wie sie viele Automatisierer versprechen.



#### agt agile technik verlag gmbh

[me] Magazin für Mechatronik & Engineering  
Teinacher Straße 34  
71634 Ludwigsburg  
Tel. +49 (0) 7141 2231-0  
E-Mail: [verpackungstag@agt-verlag.de](mailto:verpackungstag@agt-verlag.de)

[www.verpackungstag.de](http://www.verpackungstag.de)

#### HAUPTSPONSOR

#### OMRON ELECTRONICS GmbH



Elisabeth-Selbert-Str. 17  
40764 Langenfeld  
Tel. +49 (0) 21 73 68 00-0  
E-Mail: [info.de@eu.omron.com](mailto:info.de@eu.omron.com)

<http://industrial.omron.de/>

#### VERANSTALTUNGORT

#### DEUTSCHES VERPACKUNGS-MUSEUM

Hauptstraße 22 (Innenhof)  
69117 Heidelberg

[www.verpackungsmuseum.de](http://www.verpackungsmuseum.de)



#### DIE NETZWERKPARTNER

#### Die Partner des Verpackungstags

Der 3. Verpackungstag wird vom agt agile technik verlag veranstaltet und von weiteren Partnern, wie Omron als Hauptsponsor und Netzwerkpartnern, wie dem PEC sowie dem Packaging Valley und dem RKW Hessen unterstützt.



#### 3. Verpackungstag

Kongress & Micro Fair  
14. November 2018  
in Heidelberg

digital  
revolutionär  
verpackt

14. November 2018, Heidelberg

[www.verpackungstag.de](http://www.verpackungstag.de)



**Maschinen für Smart Packaging**

... und was sagen die Anwender dazu? Darum geht es auf dem 3. Verpackungstag am 14. November 2018 im Verpackungsmuseum in Heidelberg.

Wie revolutioniert die Digitalisierung die Verpackungstechnik? Es wird spannend, wenn ausgesuchte Exereten packende Lösungen vorstellen und Anwender über ihre Anforderungen und Erfahrungen sprechen. Dabei geht es nicht nur um Technologie, sondern vor allem um Zusammenhänge zwischen Prozessen, in denen Menschen und Maschinen harmonisch zusammenarbeiten.

**Gemeinsam zur besseren Performance**

Das Besondere: Der Verpackungstag verbindet Praxis mit der Theorie. Es reicht nicht, wenn die Lösung innovativ ist und den letzten Stand der Technik widerspiegelt. Es kommt auch auf die Kundenbeziehung an. Werbliche Aussagen sind deshalb tabu, wenn Maschinenbauer und ihre Zulieferpartner sowie Markenartikler und ihre Maschinenhersteller die Story einer Lösung zusammen präsentieren. Die Frage lautet: Wie erreichen Maschinenbauer, Endanwender und Komponentenpartner gemeinsam eine bessere Performance der Anlage.



**Digital, intelligent und nachhaltig**

Flexible, modular aufgebaute Maschinenkonzepte sind gefragt. Wenn Maschinen ihre Daten austauschen und in die Cloud schicken, stehen höchste Ansprüche an Engineering, Performance und Zuverlässigkeit dahinter. Wie vertragen sich Verpacken und Digitalisierung? Welche Rolle könnte ein digitaler Zwilling spielen, wenn immer unterschiedlichere Produkte effektiv verpackt werden. Erst die Schokolade, dann der Zwieback ...

Verpackung gilt als der Wachstumstreiber schlechthin. Die Hightech-Verpackung der Zukunft ist intelligent, macht Gebrauch von gedruckter Elektronik, nachhaltigen Materialien und setzt auf neueste Maschinen. Auch der 3D-Druck, Robots & Cobots sowie die Künstliche Intelligenz gehören dazu. Dabei geht es auch um vernetzte Verpackungsmaschinen und den Einsatz von Simulation wie zum Beispiel zur Berechnung der Linieneffizienz.

Auch über mehr Nachhaltigkeit wird geredet. Cradle to Cradle ist heute eine greifbare Vision. Die Zeichen der Zeit stehen für Verpackungsproduzenten auf höheren Recyclingquoten. Maschinenbauer und ihre Partner bekennen sich zur Nachhaltigkeit.

Packen wir's an! Es gibt viel zu diskutieren. Der Verpackungstag die ideale Plattform zum Networking!



**THEMEN Verpackungstag**

**Fraunhofer** **Keynote: Was ist der Kern der Digitalisierung an der Verpackungsmaschine?**  
Strategien und Beispiele: Selbstlernendes Bediener-Assistenzsystem und Reinigungssysteme an der Maschine  
Dr. Lukas Oehm, Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV, Dresden

**LOESCH PACK** **Digitalisierung von integrierten Verpackungsanlagen: Chancen und Herausforderungen**  
Wie kann ein Maschinenbauer die Flexibilität, Effizienz, Innovativität und Nachhaltigkeit der Verpackung von Süßwaren als Partner seiner Kunden verbessern?  
Dr. Thomas Cord, Loesch Verpackungstechnik GmbH

**OMRON** **Wie arbeiten Mensch und Maschine in Harmonie zusammen?**  
Wie funktioniert nahtlose Datenintegration aller Systeme in der personalisierten Produktion vom Shop-Floor bis zur MES-Ebene? Gemeinsam mit einem Partner aus der Systemintegration zeigt Omron praktische Beispiele.  
Arnd Neues/ Lucian Dold, Omron Electronics GmbH

**SCHUBERT** **Serienreife in Losgröße 1!**  
Zeit ist Geld: 3D-Druck trifft Verpackungsmaschine. Was hat der 3D-Druck mit Spotify zu tun? Gezeigt wird wie die Vorfertigung und Durchlaufzeiten verkürzt werden.  
Marcus Schindler, Gerhard Schubert GmbH

**Live On Schneider electric** **Smart Machine beim Endkunden, Herausforderungen und Lösungen**  
Stefan Mergel, Senior Product Manager Equipment, SIG Combibloc  
Reinholt Schlechter, Schneider Electric

**SEW EURODRIVE** **Hygiene mal Geschwindigkeit im Quadrat**  
Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung erklärt am Beispiel einer aseptischen Abfüllmaschine.  
Daniela Kraft, VMS ASEPTIC FILLING  
Jörg Peters, SEW Eurodrive

**BALLUFF** **Gemeinsam zur besseren Performance**  
Digital vernetzte Systeme im Dienste der Verpackung und der Verpackungsmaschinen sind die Basis immer besserer Wertschöpfung, höherer Flexibilität, Effizienz und Produktivität im Verpackungsprozess. Wie funktioniert vertikale und horizontale die Integration der Daten und welchen Nutzen haben die Anwender, wenn alles ab Shopfloor vernetzt ist?  
Dr. Elmar Büchler, Balluff GmbH

**Publikumsgespräch**  
Was sagen die Anwender zu den auf dem 3. Verpackungstag vorgestellten Lösungen